DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

008573139 \*\*Image available\*\*
WPI Acc No: 1991-077172/ **199111** 

XRPX Acc No: N91-059603

Photo sensor - has corrugated light receiving surface of photosensor formed on substrate to increase efficiency NoAbstract DWg 1/3

Patent Assignee: MITSUBISHI DENKI KK (MITQ ) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 3023678 A 19910131 JP 89158979 A 19890620 199111 B

DIALOG(R) File 347: JAPIO (c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03360778 \*\*Image available\*\*
LIGHT-RECEIVING GENERATION ELEMENT

PUB. NO.: 03-023678 [ **J** P 3023678 A] PUBLISHED: January 31, 1991 (19910131)

INVENTOR(s): TAKANO HAJIME

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan) 01-158979 [JP 89158979]

APPL. NO.: 01-158979 [JP 89158979] FILED: June 20, 1989 (19890620)

INTL CLASS: [5] H01L-031/04

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components)

JOURNAL: Section: E, Section No. 1056, Vol. 15, No. 148, Pg. 50, April

15, 1991 (19910415)

### ABSTRACT

PURPOSE: To increase a light-receiving area without increasing a substrate area by forming a light-receiving surface of a semiconductor substrate where a pn junction is formed in unevenness.

CONSTITUTION: Light-receiving surfaces 8a and 8b of a light-receiving generation element 10 and a pn junction 3a are formed in triangular unevenness, thus increasing the light-receiving area essentially. That is, rumples are attached as in the light-receiving surfaces 8a and 8b and the relative angle between the light-receiving surface 8a and the light-receiving surface 8b is set to 90 degrees, thus increasing the surface of the light-receiving area by approximately 40% as compared with the one with a flat surface shape. In this case, the irradiation method of solar rays is discussed and solar rays 7a and 7b are slanted using a mirror, a prism, etc., thus enabling light to be irradiated vertically for each light-receiving surface 8a and 8b.

F

⑩ 日本関特許庁(JP)

⑩特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-23678

Dint. Cl.

庁内整理番号 識別記号

❸公開 平成3年(1991)1月31日

H 01 L 31/04

H 01 L 31/04 7522-5F

F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

受光発電素子 の発明の名称

> ②特 頭 平1-158979

頤 平1(1989)6月20日 22)出

野 @発 明 考 高

兵庫県伊丹市東野4丁目61番5号 三菱電機エンジニアリ

ング株式会社エル・エス・アイ設計センター内

の出願 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内 2 丁目 2番 3号

外2名 弁理士 大岩 増雄 79代理人

## 1. 発明の名称

受光発電素子

## 2. 特許請求の範囲

pn接合が形成された半導体基板の受光面を、 前記半導体基板面積を増大させることなく、前配 受光面を実効的に増加せしめる凹凸状に形成した ととを特徴とする受光発電素子。

3. 発明の詳細な説明

## 〔産業上の利用分野〕

との発明は、基板面積を増大させることなく、 受光面積を増加させた受光発電素子に関するもの である。

## 〔従来の技術〕

.受光発電素子、例えば太陽電池は一般にレリコ ン基板、ガリウム砒素基板等の半導体基板に作り 付けられるが、発電の容量(起電力)を大きく取 るためには、その受光部分の面積に比例すること を考慮する必要がある。一方、半導体蒸板の面積 は、コスト面からできるだけ小さくする必要があ

第3図(a), (b)は従来の受光発電素子の構造 を示す図で、第3図(a)は一部回路を合む断面図、 第3図(b)は、第3図(a)の受光面の平面図であ る。第3図において、1はn型(またはp型)の レリコン基板、2はこのシリコン基板1の表面に 拡散等で作られたp型(またはn型)層であり、3 はpn接合である。また、4,5は電極、6は負 荷であり、11は受光発電素子を示す。

このような構造をpn接合構造といい、この接 台を含む半導体基板1の受光面8に太陽光線7等 を照射すると、これらのpn接合3間に超電力が 発生することはよく知られている。また、その起 電力は受光面8の面積に比例することもよく知ら れている。

## [発明が解決しようとする課題]

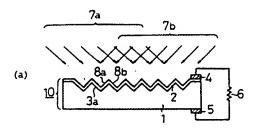
上記のように構成された従来の受光発電器子は、 受光面8の表面の形状が平坦状に作られており、 単位面積当りの起電力はとの受光面8の面積で制 限されていたため、大きな発電容量を得ることが

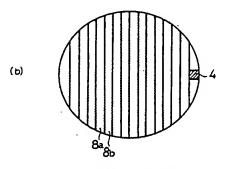
# 特開平3-23678 (3)

図において、1はn型シリコン基板、2はp型層であり、3,3 a,3 bはpn接合、4,5 は電板、6は負荷、7,7 a,7 bは太陽光線、8,8 a,8 bは受光面、10は受光発電素子である。なお、各図中の同一符号は同一または相当部分を示す。

代理人 大 岩 増 雄 (外 2 名)

# 第 1 凶





1:n型シリコン基板 2:p型層 3a:pn接合 4,5:電板 6:支援 6:大陽光線 a,8b:優光面 10:乗光紙電素子